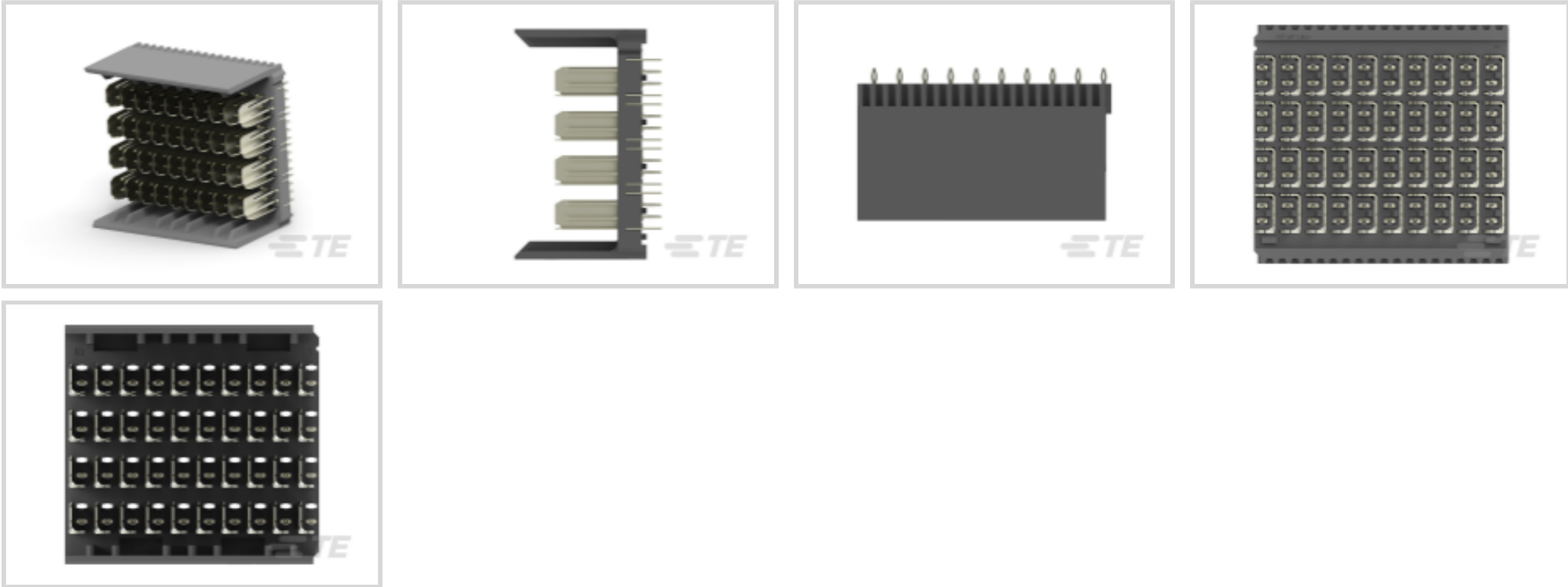




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 80
行间距: 1.5 mm [.059 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 引导槽
行数: 8

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

位数	80
行数	8
列数	10
PCB 安装方向	垂直

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

行间距	1.5 mm[.059 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

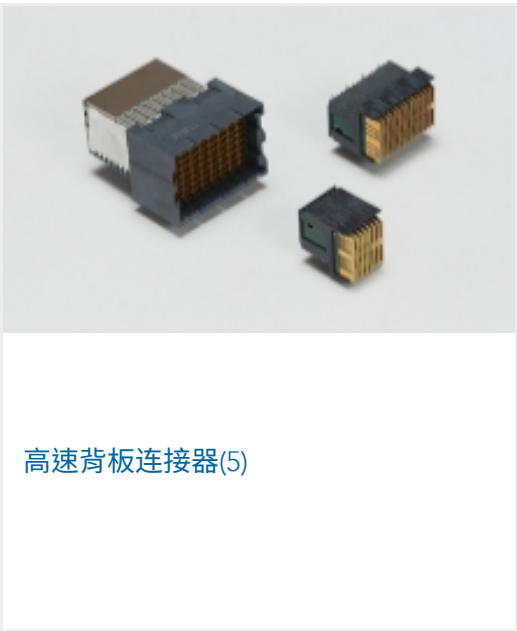
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

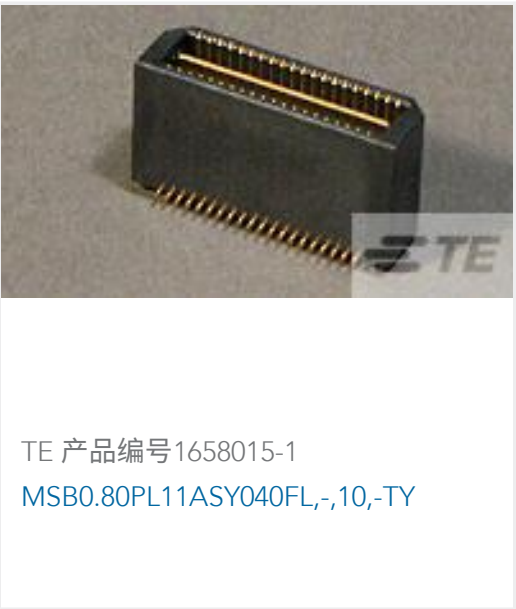
配套部件



该系列中的其他产品 | Z-PACK HM-Zd+



客户还购买了





文档

产品图纸
HMZD+,4PAIRS,10COLS,VERTICAL,ASSEMBLY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2170330-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2170330-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2170330-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本